

Registrierung

Bitte registrieren Sie sich online auf der WEB-Seite:

<http://www.cismst.de/anmeldung-avt-2018/>

Die Anmeldegebühr beträgt **150 Euro** inklusive Mehrwertsteuer. Die gesamte Korrespondenz zum Workshop richten Sie bitte an folgende Adresse:

Workshop Büro

Uta Neuhaus

CiS e.V.

Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt, Germany
Phone: +49 361 663 1160
Fax: +49 361 663 1413
E-Mail: veranstaltung@cismst.de
URL: www.cismst.de

Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr von insgesamt **150 Euro** auf folgendes Konto:

CiS e.V.
Name der Bank: Sparkasse Mittelthüringen
IBAN: DE37 8205 1000 0130 1134 25
BIC: HELADEF1WEM
Verwendung: AVT Workshop 2018

Hotelempfehlungen in Erfurt:

Mercure Hotel Erfurt Altstadt

Meienbergstraße 26-27, 99084 Erfurt
<http://www.mercure.com/en/hotel-5375-mercure-hotel-erfurt-altstadt/room.shtml>

Radisson Blu Erfurt

Juri-Gagarin-Ring 127, 99084 Erfurt
<http://www.radisson-erfurt.de/en/>

Ibis Erfurt Altstadt Hotel

Barfuesserstrasse 9, 99084 Erfurt
<http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1648-ibis-erfurt-altstadt/index.shtml>

Reiseinformationen

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH
Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt, Germany

Sie reisen nach Erfurt ...

...mit dem **Flugzeug** via Frankfurt oder Berlin

...mit dem **Auto** via Autobahn A4, Ausfahrt "Erfurt Ost"

...mit dem **Zug** zum Erfurter Hauptbahnhof und dann **Straßenbahn** (Nummer 3, Richtung "Urbicher Kreuz", bis Haltestelle "Windischholzhausen/X-Fab") bis zum CiS Forschungsinstitut.



Der Workshop findet im Konferenzraum, 3. Etage statt.



Innovative Konzepte der Aufbau- und Verbindungstechnik für MEMS und MOEMS

Dienstag, 16. Oktober 2018

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH



Dieser Workshop wird organisiert vom CiS e.V.

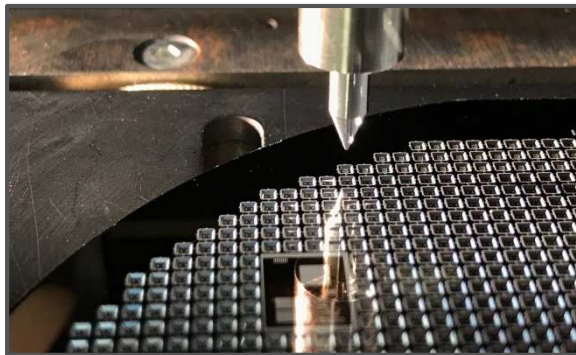


Über den Workshop

Dieser Workshop richtet sich an Interessenten der Wissenschaft und Wirtschaft, die sich mit neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) vertraut machen wollen.

AVT für MEMS-Sensoren, Hochleistungs-LED Module sowie IR-Sensorsysteme

In Fachbeiträgen wird dargestellt, wie beginnend vom Design eines Siliziumchips über Analysemethoden bis hin zum komplettierten Sensorsystem, Lösungen gefunden werden, welche eine zuverlässige und rückwirkungsarme Montage ermöglichen.



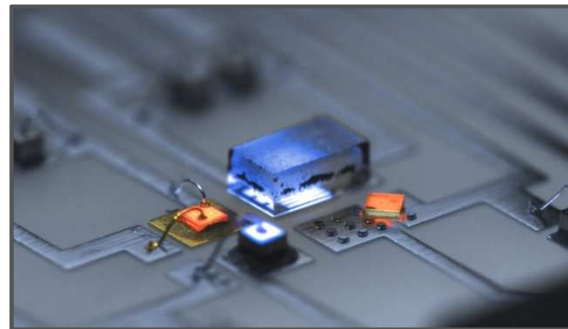
Automatisches Handling von Chips

Schwerpunkte sind das Handling und die spannungsoptimierte Montage extrem dünner Silizium-Kraftsensoren, die Miniaturisierung und das Wärme-Management bei optischen Hochleistungsbaugruppen sowie Montagelösungen auf Waferlevel. Weiterhin werden Lösungswege zur Realisierung hermetischer oder thermisch stark belastbarer multifunktionaler Packages für die Infrarot-Sensorik aufgezeigt.

Ziele

Das Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung im Bereich der Aufbau- und Verbindungstechnik für siliziumbasierte MEMS-Sensoren wie zum Beispiel Drucksensoren oder Si-Dehnmessstreifen, für IR-Komponenten und Hochleistungs-LED zu präsentieren und zu diskutieren.

Dabei werden Aspekte von Simulation und Design über die Prozessentwicklung bis zur Charakterisierung und Analyse kompletter Baugruppen betrachtet.



Kombination von COB- und Flip-Chip-Montage zur Realisierung von multispektralen Beleuchtungsquellen

Agenda

Eröffnung & Überblick

- 9:30 **Begrüßung**
Prof. Thomas Ortlepp, CiS Forschungsinstitut
- 9:40 **SiCer-Technologie**
Prof. Jens Müller, TU Ilmenau
- 10:15 **Montage-Technologien für mikrooptische und mikromechanische Systeme im CiS**
Überblick und Entwicklungstrends
Dr. Michael Hintz, CiS Forschungsinstitut

SESSION I - Miniaturisierte Kraftsensoren-vom Design zur Technologie

- 11:00 **Simulation und Design von chipintegrierten Entspannungsstrukturen zur rückwirkungsarmen Montage von Drucksensoren**
Dominik Karolewski, CiS Forschungsinstitut
- 11:30 **Silizium-Dehnmessstreifen - Vorteile und Entwicklungstrends**
Dr. Thomas Frank, CiS Forschungsinstitut
- 11:50 **Aufbau- und Verbindungstechnik ultradünner Siliziumchips am Beispiel von Dehnmessstreifen**
André Grün, CiS Forschungsinstitut

SESSION II - LED-Montage-aktuelle Trends

- 12:40 **Session Keynote: Entwicklung bei UV-LEDs**
n.n., OSRAM Opto Semiconductors GmbH
- 13:10 **Anforderungen an die Montage von Hochleistungs-LEDs**
Dr. Sabine Nieland, CiS Forschungsinstitut
- 13:30 **Multifunktionale Silizium-Packages für LEDs**
Dr. Indira Käßlinger, CiS Forschungsinstitut

SESSION III - Siliziumbasierte IR-Sensorsysteme

- 14:05 **Session Keynote: Perspektivische Anforderungen an IR-Komponenten aus Sicht der Gas-Sensorik**
Steffen Biermann, Micro-Hybrid Electronic GmbH
- 14:35 **Technologieentwicklung von hermetischen Packages für IR-Komponenten**
Kristin Neckermann, CiS Forschungsinstitut
- 14:55 **Simulationsaspekte IR**
Julia Baldauf, CiS Forschungsinstitut

Diskussion & Networking

Der Workshop ist in Übersichts- und Fachvorträge zu verschiedenen technologischen Schwerpunkten unterteilt. Die Moderation des Workshops übernimmt Dr. Hans-Joachim Freitag, Vorstandsvorsitzender des CiS e.V.